

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2026-012

深圳市兆驰股份有限公司

关于对外投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块

项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目（一期）的公告》《关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目（一期）的公告》。为加速推动公司在光通信领域的发展，促进高科技产业转型升级，实现公司多产业横向融合与多赛道协同发展，公司拟通过全资子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）或其下属子公司以自有资金或自筹资金投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”（以下简称“激光芯片项目”），建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线；同时，公司拟通过全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“兆驰通信”）的下属子公司江西兆驰光联科技有限公司（以下简称“兆驰光联”）以自有资金或自筹资金投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”（以下简称“高速光模块项目”），建设光通信高速模块及光器件制造生产线，项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块。上述两个项目拟投资金额均不超过5亿元，最终投资总额以实际投入为准。

二、对外投资进展情况

目前，公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造基地建设并全面启用。截至本公告日，200G及以下光模块已规模化生产；首批400G/800G并行光收发模块全流程制造生产线已完成设备安装与调试，400G/800G光模块可靠性测试完成已进入小

批量生产阶段，并有序推进至规模化量产阶段；1.6T光模块已进入快速研发阶段，围绕LP0、NP0、CP0多路径并行攻关，构建下一代高速低功耗解决方案。

同时，公司激光芯片项目也取得阶段性进展。公司前期已配置20腔可兼容LED砷化镓芯片与激光芯片生产线的MOCVD（金属有机化学气相沉积）设备，目前已增补部分后段设备，建成激光芯片生产线。公司可根据产品研发、验证测试进度及客户订单需求，灵活协调LED砷化镓芯片与激光芯片的产能分配，保障激光芯片产能供给。截至本公告日，25G DFB及以下速率光芯片已完成研发及试生产，逐步向量产阶段过渡；应用于400G/800G/1.6T光模块的大功率系列CW DFB激光芯片和50G EML激光芯片正在按既定计划稳步推进研发；面向Micro LED光互连CPO（共封装光学）技术的Micro LED光源芯片已完成研发工作，目前处于样品验证测试阶段。

三、对公司的影响

自2023年起，公司进一步聚焦光通信领域布局，已初步构建起涵盖终端光通信器件、光模块及核心零部件光芯片的垂直产业链。本次项目投资符合公司战略发展规划，核心目的在于加速光通信全产业链布局，进一步推动公司整体产业升级，增强核心竞争力与行业影响力，为公司持续发展注入新动能，奠定可持续发展基础。本次投资基于公司光通信业务发展需求开展，对完善光通信领域光芯片、光器件、光模块的垂直产业链战略布局具有积极推动作用，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

四、风险提示

公司激光芯片项目及高速光模块项目目前正处于稳步推进的投产初期阶段，产能爬坡及市场拓展需一定周期。后续项目生产经营过程中可能面临潜在风险，包括但不限于市场环境变化、行业政策调整、竞争格局变动、终端需求波动等，上述风险因素可能对项目实施进度及预期收益造成不确定性影响。公司将持续通过动态调整生产计划、优化供应链管理、强化市场研判等措施积极应对各类潜在风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

2026年3月13日